

SINGLE PHASE - Rating
TYP WYMIENNIKA CIEPŁA : IC8Tx30

Medium strona 1 : Woda
 Medium strona 2 : Woda

Flow Type : Counter-Current

WARUNKI PRACY

		STRONA 1	STRONA 2
Moc cieplna	kW	20,00	
Temperatura wejściowa	°C	140,00	60,00
Temperatura wyjściowa	°C	65,00	80,00
Przepływ	kg/s	0,06321	0,2386
Max. spadek ciśnienia	kPa	50,0	50,0
Jedn. przenoszenia ciepła		3,39	0,90

PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

		STRONA 1	STRONA 2
Całkowita powierzchnia wymiany ciepła	m ²	0,644	
Strumień ciepła	kW/m ²	31,1	
Średnia log. różnica temperatur	K	22,13	
Śr. wsp. wymiany ciepła (wynikowy/wymagany)	W/m ² , °C	2760/1400	
Spadek ciśnienia- całkowity	kPa	0,317	3,48
- w podłączeniach	kPa	0,0495	0,692
Średnica podłączenia	mm	16,0	16,0
Ilość kanałów		14	15
Ilość płyt		30	
Przewymiarowanie	%	97	
Współczynnik zanieczyszczenia	m ² , °C/kW	0,340	
Liczba Reynoldsa		450	1080
Prędkość w podłączeniach	m/s	0,329	1,21

WŁASNOSCI FIZYCZNE

		STRONA 1	STRONA 2
Temperatura odniesienia	°C	102,50	70,00
Lepkość	cP	0,275	0,404
Lepkość - ścianka	cP	0,350	0,356
Gęstość	kg/m ³	956,6	977,7
Ciepło właściwe	kJ/kg, °C	4,219	4,192
Przewodność cieplna	W/m, °C	0,6798	0,6631
Min. temperatura media na ścianke	°C	61,81	
Max. temperatura media na ścianke	°C		97,25
Wsp. wymiany ciepła	W/m ² , °C	4330	9610
Średnia temperatura ścianki	°C	81,08	79,64
Prędkość w kanałach	m/s	0,0323	0,111
Shear stress	Pa	0,849	8,84

Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistance- can be found in SWEP product sheets and other technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

*Excluding pressure drop in connections.